

Draft

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

หนังสือ

ปารเมศ ชูติมา. (2545). การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บทความ

วิรัตน์ ศรีอมรกิจกุล. (2534, เมษายน). “พื้นฐานของเทคโนโลยีเซอร์เฟสเมตส์.” วารสารส่องโลกเทคโนโลยี. หน้า 12-33.

ภาษาต่างประเทศ

BOOKS

Clyde F. Coombs, Jr. (1995). **Printed Circuits Handbook**. McGraw-Hill.

Donald G. Fink, and H. Wayne Beaty. (1987). **Standard Handbook for Electric Engineers** (12 th ed.). Editor McGraw-Hill.

Jennie S. Hwang. (2001). **Environment-Friendly Electronics: Lead-Free Technology**. Electrochemical Publications.

Martyn S. Ray. (1987). **The Technology and applications of Engineering Material**. Prentice Hall International.

S. S. Manson. (1966). **Thermal Stress and Low-Cycle Fatigue**. New York : McGraw-Hill.

ARTICLES

- A. Miller and R. H. Priest. (1987). "Materials Response to Thermal-Mechanical Strain Cycling." **Elsevier Applied Science**. pp.113-175.
- Jennie S. Hwang, and Z. Gue. (1993). "Lead Free Solder For Electronics Packaging." **Surface Mount International**. p.733.

ELECTRONIC SOURCES

- Douglas Leys and Steven P. Schaefer. (2001). PWB Dielectric Substrates for Lead Free Electronics Manufacturing. Retrieved September 24, 2004, from Park. Electrochemical Corp website. <http://www.parknelco.com>
- Matt Kelly, Quyen Chu and Jasbir Bath (2002). Lead Free Assembly Process Optimization. Retrieved May 15, 2004, from <http://www.circuitree.com>
- Mark Cannon (2003). PWB Process for Lead Free Technology. Retrieved May 11,2003, from <http://www.pcfab.com>
- Ulrich Zimmer and Bill Birch (2003). Lamination Process Parameter Optimization. Retrieved April 25, 2003, from <http://www.pcfab.com>
- Robert Demaree (2001). Halogen Free Material for Lead Free Technology. Retrieved August 15, 2004,from <http://www.circuitree.com>
- Ronald DePace and Wennei Chen (2003). Solder Joined Reliability study. Retrieved December 23,2004, from <http://www.circuitree.com>